

●2025 年度精密工学会春季大会特別シンポジウム 第2弾 (参加費無料, 事前申込制)

「半導体製造装置開発の最前線」

～業界トップクラスの技術者が登壇 技術をわかりやすく解説します～

半導体はあらゆる産業の活動を支える技術基盤を提供しています。生成 AI の発展や自動車の知能化を始め、DX の急速な拡大と高度化によって、その役割は増すばかりです。今日の半導体にはナノメートルサイズの 3 次元構造が組み込まれており、微細化と高集積化において、終わりのない進化を続けています。

本シンポジウムでは、日本半導体製造装置協会 (SEAJ) のご協力により、世界トップレベルの技術力とシェアをもつ日本の半導体製造装置メーカーの研究者に講演いただきます。最先端の CMP 研磨技術、パッケージング関連技術、テスト技術など、半導体製造に欠かせない技術分野の最新の研究開発や課題を解説していただきます。

学会の研究者・技術者の方々には、様々な点で興味深いニーズやシーズを見つけていただけたらと思います。また、学生さんには魅力や親近感を感じていただけたらと思います。学会とは近そうで少し疎遠でもあった半導体製造技術分野との繋がりのお機会になれば幸いです。

日時: 2025 年 3 月 17 日 (月) 13:15~15:50 (予定)
会場: 千葉工業大学 津田沼キャンパス 4 号館 435 室 (春季大会会場内)
会 会: 岩本花子 (株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ)
福地貴久 (株式会社アドバンテスト)

次 第: (予 定)

時 間	題 目	内 容	講 師
13:15	主催者挨拶	精密工学会より	精密工学会会長 山内 和人
13:20~13:55	「研磨技術」 CMP装置の基礎	現在、半導体製造において必須工程の一つとなっている CMP 装置(化学的機械的研磨装置)の基本構成、重要要素技術、近年の課題について解説します。	(株)荏原製作所 精密・電子カンパニー 装置事業部 技術マーケティング課 課長 岩佐 毅彦
13:55~14:30	「研削技術」 アドバンスドパッケージに呼応する バックグラインド 技術の最新動向	近年、パッケージ技術の発展に伴いバックグラインド技術は従来の基板薄化目的からデバイス、もしくはパッケージ自体の機能向上を目指す手段として適用範囲を拡大しています。本講演ではバックグラインド工程に求められる最新技術を紹介致します。	(株)東京精密 半導体社 技術部門 加工・バックエンド技術部 アプリケーションセンター BG チーム 主査 佃 昌治
14:30~15:05	「樹脂封止技術」 半導体の保護だけでなく高機能化を支えるモールド イソング技術	半導体はさらなる高機能化、限られた設置空間への搭載が求められています。これらを実現するにはパッケージングの小型・軽量化・信頼性を高める必要があります。こうした要求に応えるためのモールドイソング技術について紹介致します。	TOWA(株) 装置開発部 課長 白澤 賢典
15:05~15:40	「試験技術」 半導体デバイスの 機能・性能・品質・ 信頼性を保証し、 「良品」という付加価値 を与える	半導体デバイスの微細化・高集積化に伴い、搭載機能の増加、回路性能の向上が進むに連れて、品質と信頼性に対する要求はより厳しくなっています。デバイスの機能・性能・品質・信頼性を保証するために、デバイス試験が重要な役割を果たします。本講演では、半導体デバイスの試験技術について概略を紹介致します。	(株)アドバンテスト テクノロジー開発本部 テクノロジー統括部 第5 開発部 FT テクノロジー開発 2 課 課長 石田 雅裕
15:40	協賛者挨拶	日本半導体製造装置協会より	日本半導体製造装置協会 専務理事 渡部 潔
15:45	閉会の挨拶	2025 年度春季大会実行委員会より	大会実行委員会委員長 松井 伸介

*受付開始: 12:45~

【連携企画】 新技術講演会: 16:00~17:45

同日 16:00 から同会場にて「新技術講演会 (精密工学会技術賞受賞講演)」を予定しています。合わせてご参加ください。

お申込み

主催: 公益社団法人 精密工学会 (JSPE)
協賛・後援: 一般社団法人 日本半導体製造装置協会 (SEAJ)
参加費: 無料, 事前申込制
申込方法: ホームページ (<https://2025-03spring.jspe.or.jp/semiconductor-sympo/>)
または、右の QR コードからお申込み下さい。
申込み期限: 2025 年 3 月 3 日 (月)
申込先: 公益社団法人 精密工学会 (URL: <https://www.jspe.or.jp/>)

